

① 日本國特許庁
公開特許公報

- ①特開昭 51-21192
④公開日 昭51.(1976) 2.20
②特願昭 49-93082
②出願日 昭49.(1974) 8.14
審査請求 未請求 (全4頁)

⑤ Int. Cl.²
H01B 5/14

- 方 式 登 載
- 1 週
1 週
1 週
- 中國第二版
社 印
- 49-093088

また従来の導電性被覆剤はそれ自身がいかなる方向にも導電性を有するように導電性粒子の集合割合を極めて高くしてあり、この結果例えばエポ

キシ系接着剤などの占める割合が低くなり、接着強度の面からも問題があつた。

本発明は上記欠点を除去すゝもので、非導電性ベースに所定大の導電性粒子を互いに接触しないよう割合で混合してシート状に成形することにより、厚み方向のみの導通をとることが可能で、横方向には非導電性としたものである。

まず本発明の導電性接着シートについて説明する。

第2図示のように本発明の導電性接着シート1は、非導電性ベース2とこの非導電性ベースにより互いに接触しないような状態に保持されている導電性粒子3とからなり、これを導電性粒子3の大きさにほぼ等しい厚さのシート状に成形したもので、第1図はこの導電性接着シート1をロール状に巻いたものである。非導電性ベース2には熱可塑性接着剤、熱可塑性樹脂、例えば、ポリエチレンテレフタレート（商品名：マイラー）、ポリプロピレン（商品名：テフロン）、アクリルポリアミド（ナイロン）あるいは低融点ガラス

同族接合法、超音波接合法などの適宜手段を用いて加熱押圧する。加熱されることにより非導電性ベース2は溶融状態となり、導電性粒子3は端子7、8に接合する。加熱を止め、非導電性ベース2が硬化すると、プリント基板4とフラットケーブル5とは第4図示のように非導電性ベース2により機械的に接着され、かつ対向する端子7、8は導電性粒子3を介して導通状態となる。しかし隣接する端子間の導通はない。このことからわかるように導電性粒子3の混合割合は、導電性粒子3の形状、大きさ、および端子の間隔、ピッチなどにより適宜決定されるもので、要するに互いに接触しない状態で、かつ接続しようとする端子などの対向部材間に1個以上の導電性粒子3が存在し、横方向には所望の絶縁抵抗が得られるよう割合で用いられる。望ましくは導電性粒子3は全体積の50パーセント以下の割合で混合される。

つぎに導電性接着シートを予めその用途に応じて所定形状に型成形して使用する場合はプリント

特開 昭51-21192(公)

などのように電気的には絶縁性で、加熱することにより溶融状態になる材料が選択適用される。また導電性粒子2にはカーボン粉末、B₄C粉末、

いは金属粉例えばAg還元粉末、Au粉末、Pd/Ag粉末、Ni粉末、In粉末、などの導電性に優れたものが用いられる。その大きさは直径が5〜100ミクロン程度で、望ましくは均一径で球状粒子のものがよい。

そこでこの導電性接着シート1を使つて電気的導通をとる具体例について説明し、本発明の内容をさらに明確にする。

まず第3図および第4図を参照して、プリント基板4とフラットケーブル5との接続について説明する。プリント基板4の一端部は接続部6となつてあり、この部分にプリント配線7の接続端子7が形成されている。一方のフラットケーブル5にもこれと対応して導電性導体8の接続端子8が形成されている。そこで導電性接着シート1を適当な長さに切つて、プリント基板4の接続部7上に重ね、さらにその上にフラットケーブル5を重ねる。そしてその重合部分を加熱溶接法、高

基板とLSIとの接続を例にとつて説明する。第5図に於いて、9はLSIであり、10はその接続端子である。11はプリント基板であり、このプリント基板にはLSIの端子10と接続する導体12がプリント配線されている。13はLSIの端子10に対応して型抜き成形した導電性接着シートである。この場合をナシート13をプリント基板11の所定位置に置き、その上にLSIをその端子10を導体12と合わせて載置する。その後前述のように適宜手段を用いて加熱押圧すると、第6図示のような状態でプリント基板11とLSIとの接続がなされる。すなわち対向する導体12と端子10とは非導電性ベース2により機械的に接着がなされると共に、導電性粒子3を介して電気的にも導通されるのである。もちろんこの時も各導電性粒子3は接触していないので、隣接する端子間の短絡はない。

第7図のものは、非導電性ベース2に導電性粒子3の他にさらに導電性微粒子13を入れて、上下方向の導電性を改良しようとするものである。この導電性微粒子13の材質は導電性粒子3に用いら

れ 前述の から適宜選択される。また導電性微粒子13は数 μ m程度、好ましくは導電性粒子3の直径の10分の1程度の鱗片状のものが用いられる。しかし導電性微粒子13を混入する場合は、あくまで横方向の導通が生じないようにその混合割合を決定しなければならない。

さらに第8図示のものは、導電性粒子3と共に絶縁性粒子14を入れて、横方向の非導電性を高上させようとするものである。この絶縁性粒子14としては、 Al_2O_3 、 SiO_2 、 Si_3N_4 などの金属酸化物の他、 MgO 、 $CaCO_3$ 、ガラス粉末、さらに合成樹脂などの有機物粉末などの使用が可能で、大きさは導電性粒子3よりも小さいことが好ましい。混入割合は要求される横方向の絶縁抵抗に応じて定められるが、導電性粒子3の間に絶縁性粒子14が存在し、導電性粒子同士が接触しないようにするのが望ましい。

また非導電性ベース2について上記例では、熱溶融性の材料を用いて、これを加熱押圧していたが、第9図示のように導電性粒子3を露出させて

おき、単に接合しようとする 端子間などに挟んで加熱することなく圧接するようにしてもよい。

またその両面に接合剤を塗付しておいて、圧接した場合に導電性粒子が接合剤の層より突出するようにしてもよい。

本発明は上記した如く厚さ方向のみの導通は容易にとれ、横方向には導電性がないので接合しようとする端子間の導通が確実に、しかも能率よく行なえる。さらに従来の導電性接合剤に比べ、混入粒子が少ないために接合強度も十分であり、接合剤としての信頼性も高い。また使用する個所に応じて適宜形状に塗布を成形しておけばさか一方便利である。

図面の簡単な説明

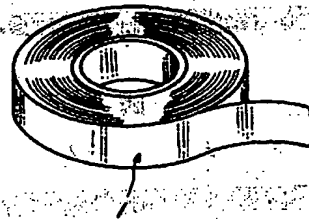
図面は本発明の一実施例を示すものであつて、第1図は導電性接合シートをロール状に巻いた状態の斜視図、第2図はその内部の拡大断面図、第3図はプリント基板とフラットケーブルとの接続の場合の展開斜視図、第4図はその接続状態を示

す要部拡大断面図、第5図はプリント基板とLSIとの接続の場合の展開斜視図、第6図はその接続状態を示す一部断面拡大側面図、第7図は他の実施例の拡大断面図、第8図はさらに他の実施例の拡大断面図、第9図はさらに他の実施例の拡大断面図である。

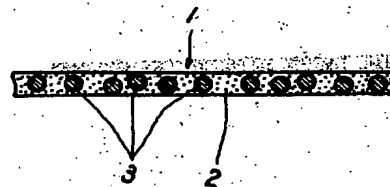
2.....非導電性ベース 3.....導電性粒子
13.....導電性微粒子 14.....絶縁性粒子

代理人 最 上 務

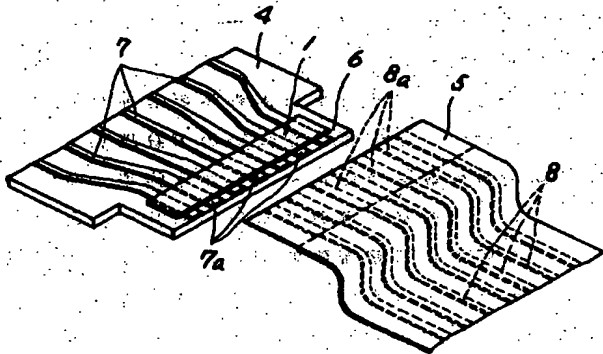
第1図



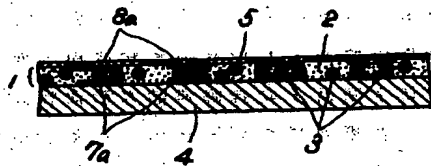
第2図



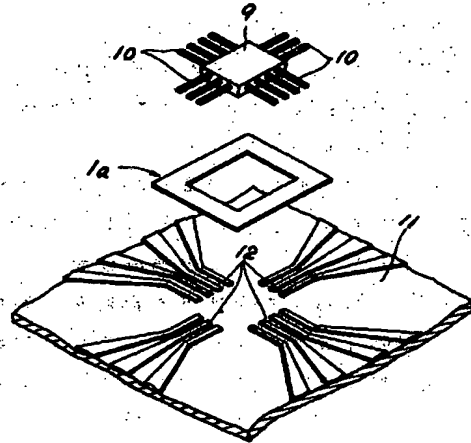
第3圖



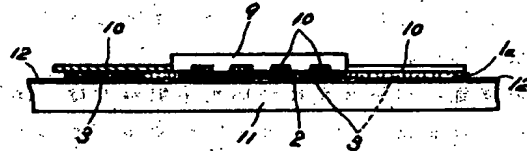
第4圖



第5圖



第6圖



第7圖



第8圖



第9圖



7. 上記以外の発明者

千葉県習志野市琴芝人長4丁目1番24号
橋本 隆 啓